

8 μ m超薄型FPC用 電磁波シールドフィルム

SF-PC5900-C



総厚8 μ mという超薄型の電磁波シールドフィルムを実現しました。
しかも温度環境が-20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ Cの広範囲においても、屈曲半径0.65mmで100万回以上の摺動・屈曲寿命が可能です。
さらにハロゲンフリーでありながら高難燃化し、燃焼クラスはUL94 VTM-0(登録)を達成しています。超薄型を達成してもシールド性能などの基本特性やFPCへの加工性は従来のSF-PC5500と変わりません。
より「薄く」、より「軽く」を実現し、携帯端末用途でのご要求にお応えします。

特徴

- ▶ **総厚8 μ mの超薄型を達成**
従来のシールドフィルムSF-PC5500より約50%厚みを低減
- ▶ **広い温度範囲での高摺動屈曲性を実現**
屈折半径R=0.65mm以上のスライド式携帯電話でも屈曲寿命が100万回以上
- ▶ **UL94 VTM-0登録**
ハロゲンフリーでありながら、UL94 VTM-0を達成しました
- ▶ **OSP処理にも対応可能**
シールドフィルム貼合せ基板でのOSP処理にも対応可能
- ▶ **充実した環境適合性**

UL登録内容

UL94 VTM-0(Kapton50Hとの組み合わせ)
※Kapton®は米国デュポン社の登録商標です

環境適合性

環境対応	SF-PC5900-C
UL94 燃焼クラス	VTM-0
ハロゲンフリー	適合
RoHS指令	適合
鉛フリーハンダリフロー対応	適合

SF-PC5900-Cの構成

